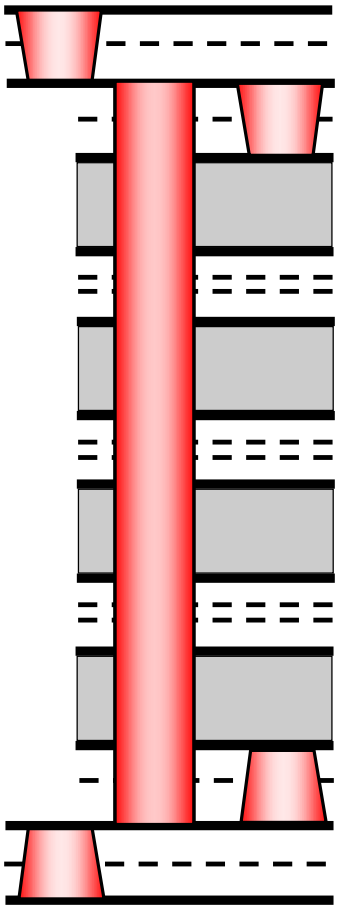
LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI12_2+8(10b)+2_1,35_35 — **12 - Lagen**

Kerne: 0,10 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:	**2 + 8(10B) + 2**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK



LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS	Folie	12 µm	1)	12	
				1 x 1080	60	
2	VSK1	Folie	9 µm		30	
				1 x 1080	60	
3	2		35 µm		33	
		0,100 mm			100	
4	3		35 µm		33	
				2 x 1080	124	
5	4		35 µm		33	
		0,100 mm			100	
6	5		35 µm		33	
				2 x 1080	124	
7	6		35 µm		33	
		0,100 mm			100	
8	7		35 µm		33	
				2 x 1080	124	
9	8		35 µm		33	
		0,100 mm			100	
10	9		35 µm		33	
				1 x 1080	60	
11	RSK1		9 µm		30	
				1 x 1080	60	
12	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1360

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,35**	+/-	0,11	mm	Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,44	+/-	0,14	mm		
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,50	+/-	0,16	mm		
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:	

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
29.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	14+